

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)为更好的实施公司发展战略，确保公司控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司(以下简称“微组半导体”或“子公司”)日常经营业务的顺利开展，公司拟为子公司向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 1,500 万元担保额度，上述担保期限以实际签订的担保合同为准。同时，授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行办理相关法律文件的签署事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为子公司提供担保金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	深圳市微组半导体科技有限公司
法定代表人	胡靖林
成立时间	2017 年 10 月 18 日
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
统一社会信用代码	91440300MA5ERYA88Q

注册地和主要经营地	深圳市宝安区松岗街道沙浦社区洋涌工业区八路2号碧桂园厂房6栋401
与公司存在的关联关系	为公司控股子公司（公司持有微组半导体70%的股权）
经营范围	半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的研发和销售；提供相关生产工艺的技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备的租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的生产。

2、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
总资产	3,268.77	1,870.78
总负债	3,000.72	1,263.14
净资产	268.06	607.64
营业收入	1,194.54	1,908.91
营业利润	-419.87	176.34
净利润	-339.58	165.98

注：上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

微组半导体自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

三、担保内容

公司本次为控股子公司微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过1,500万元担保额度，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司微组半导体提供的担保系为保证控股子公司的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。微组半导体经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进

行控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保，并同意授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行办理相关法律文件的签署事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为：被担保方微组半导体系公司控股子公司，公司为微组半导体提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。微组半导体经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为子公司向银行申请授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司审议通过的对外担保总额为人民币 2,000 万元（不含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的 2.61%；实际发生的对外担保总额为人民币 1,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.22%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议文件；
- 2、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日